



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名：東京エレクトロン株式会社
代表者名：代表取締役社長 竹中 博司
(コード番号：8035 東証第1部)
問合せ先：経理部長 小俣 良二
(TEL 03-5561-7000)

業績予想及び配当予想に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 28 日に公表しました「平成 23 年 3 月期 決算短信」において、平成 24 年 3 月期の業績予想及び配当予想を未定としておりましたが、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 24 年 3 月期の業績予想及び配当予想を決定致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 業績予想について

平成 24 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間連結業績予想数値

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
今回発表予想 (A)	335,000	35,000	36,000	23,000	128.45
前年同期実績 (B) (平成 23 年 3 月期第 2 四半期)	318,400	42,342	45,107	33,454	186.88
増減額 (A-B)	16,599	△7,342	△9,107	△10,454	
増減率	5.2%	△17.3%	△20.2%	△31.2%	

平成 24 年 3 月期通期連結業績予想数値 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
今回発表予想 (A)	730,000	100,000	102,000	66,000	368.60
前期実績 (B) (平成 23 年 3 月期)	668,722	97,870	101,919	71,924	401.73
増減額 (A-B)	61,277	2,129	80	△5,924	
増減率	9.2%	2.2%	0.1%	△8.2%	

[業績予想の理由]

半導体関連市場につきましては、期前半に東日本大震災の影響が一部ありますが、最終製品の需要増加を背景に通期では半導体メーカーの設備投資は引き続き増強されるものと想定されております。以上により、当社グループの平成24年3月期の連結業績を上記のとおり予想しております。

(注) 業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 配当予想について

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
今回発表予想	45.00円	85.00円	130.00円
前期実績(平成23年3月期)	38.00円	76.00円	114.00円

[配当予想の理由]

当社の配当政策は、業績連動型・収益対応型配当の継続実施であり、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途とすることを株主還元の基本方針としてまいりましたが、平成22年11月2日開催の取締役会において、平成23年3月期期末配当から連結当期純利益に対する配当性向35%を目途とする方針に変更しております。

上記平成24年3月期の業績予想の公表に伴い、平成24年3月期の配当予想につきましても公表するものであります。

以 上